

软质芯片打孔器

PDMS 等软质芯片在使用过程中基本都需要打孔，接入导管实现流体的通入。由于软质芯片的材料特性，非专业设备打孔经常会出现带孔倾斜、打孔位置偏移、孔道碎屑残存等问题，苏州文颢开发了以下三款打孔设备，供广大微流控芯片使用人员选择。

简易软质芯片打孔器 (WH-CF-12)



基于离心管和注射器针头改装而成，针头规格如下，产品价格较低，针头可更换。

规格	内径 (mm)	外径 (mm)
8	3.3	4.0
10	3.0	3.5
11	2.4	3.0
12	2.3	2.8
13	1.9	2.4
14	1.6	2.1
15	1.2	1.8
18	0.9	1.3
20	0.6	0.9
21	0.5	0.8
22	0.4	0.7



手持软质芯片打孔器 (WH-CF-13)

手持式打孔器由中空针头和手握管体组成，中空针头经过了机械倒角打磨处理，打孔的得到的芯片孔径与针头内径一致。产品符合人体工程学设计，简单易用，相较于建议打孔器，打孔更深、更直。

针头内径规格 (mm): 0.5/0.75/1.0/2.0/2.5/3.0



台式打孔器 (WH-CF-14)

台式打孔器打孔深度可以达到 20.0mm，避免了手动打孔产生的误差，利用杠杆原理，可以针对材质较硬的芯片进行打孔。可以更换内径为 1.78-9.0mm 的针管。如果需要，可以配合显微镜使用。

